

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟签署的《投资意向书》仅为意向性协议，在后续实施过程中尚存在不确定性因素，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署；标的公司及其实际控制人承诺，本轮融资至少包含 1 个以上除思泰克外的其他投资机构，截至本公告披露日，标的公司尚未确定其他投资方；本次对外投资事项的实施进度以及最终交易能否完成尚存在不确定性，可能存在对标的公司的进一步投资方案进行调整或取消的风险；

2、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）于 2025 年 6 月 26 日分别召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》，同意公司与华睿芯材（无锡）科技有限公司（以下简称“华睿芯材”或“标的公司”）、苏阳先生（华睿芯材实际控制人）签订《投资意向书》，公司拟以自有资金人民币 1,200 万元对华睿芯材进行增资，其中 128 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。若本次交易顺利完成，华睿芯材将成为公司的参股公司，公司直接持有其 3.75% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 标的公司基本信息

公司名称：华睿芯材（无锡）科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MA258LG675

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏阳

注册资本：人民币 3,200 万元

成立日期：2021 年 2 月 23 日

营业期限：2021 年 2 月 23 日至无固定期限

注册住址：无锡市滨湖区蠡园开发区 06-4 地块（滴翠路 100 号）8 幢 1 层

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 本次增资前后标的公司股权结构变化

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
北京华睿新能动力科技发展有限公司	2,200	68.75%	2,200	64.45%
华控技术转移有限公司	500	15.63%	500	14.65%
何向明	250	7.81%	250	7.32%
徐宏	250	7.81%	250	7.32%
厦门思泰克智能科技股份有限公司	-	-	128	3.75%
其他投资方	-	-	85.3333	2.50%
合计	3,200	100.00%	3,413.3333	100.00%

(三) 标的公司主要财务指标

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------	---------------------------

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,105,028.48	11,514,560.20	13,670,833.35
负债总额	177,597.20	108,205.09	110,844.00
净资产	23,927,431.28	11,406,355.11	13,559,989.35
项目	2024 年 (经审计)	2023 年 (经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	-	-	-
净利润	-3,478,923.83	-2,153,634.24	-1,479,631.89

华睿芯材目前处于中试及产业化运营阶段，尚未实现销售收入。

(四) 其他情况

1、华睿芯材与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、经查询，截至本公告披露日，华睿芯材不属于失信被执行人。

3、截至本公告披露日，华睿芯材章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、《投资意向书》的主要内容

(一) 协议签署主体

甲方：厦门思泰克智能科技股份有限公司

乙方：华睿芯材（无锡）科技有限公司

丙方（乙方的实际控制人）：苏阳

(二) 投资金额

甲方同意以 9.375 元/注册资本的价格认缴乙方新增注册资本人民币 128 万元，投前估值为人民币 30,000 万元，乙方同意接受甲方的本次增资；本次增资中，甲方应以货币方式向乙方支付增资款人民币 1,200 万元，其中 128 万元计入乙方实收资本，1,072 万元计入乙方资本公积。

(三) 交割

双方同意，甲方应于本投资意向书签署后 10 个工作日内向乙方支付 50% 增资款即人民币 600 万元，于乙方股东会通过本次增资的决议且全体股东完成在该决议上签字盖章之日起 10 个工作日内向乙方支付剩余增资款人民币 600 万元。

(四) 实控人担保条款

丙方应对甲方支付的增资款即人民币 1,200 万元提供担保，若乙方在收到第

一笔增资款后 12 个月内未按约定完成甲方对乙方增资的工商变更登记，甲方有权要求乙方退还已支付的全部增资款，丙方为乙方退还甲方增资款之义务承担连带保证责任。

（五）甲方投资的前提条件

甲方在最终协议中的交割义务以满足下列条件为前提：

- 1、甲方及其顾问完成对标的公司的全部业务、财务、法律的尽职调查，且调查结果令甲方满意；
- 2、签署和交付本次投资的最终协议；
- 3、相关审批部门对于本次投资的适当批准和批复(如需)；
- 4、标的公司在商业/法律/财务等方面无重大负面变化；
- 5、标的公司和创始股东在最终协议中的陈述和保证继续真实有效且无重大不利的变化；
- 6、标的公司和创始股东已经履行最终协议中规定的需要在交割前履行的义务；
- 7、本次投资已得到了甲方的董事会或投资决策机构的批准；
- 8、标的公司的股东会已表决通过本次投资事项。

（六）回购权

- 1、乙方未能于 2025 年 12 月 31 日前完成实现产品销售收入且相关收入已根据《企业会计准则第 14 号——收入》确认；
- 2、乙方未能于 2028 年 12 月 31 日前完成经甲方认可的合格投资机构以投后估值不低于人民币陆亿元整完成不低于本轮融资金额的股权融资；
- 3、标的公司未能在 2030 年 12 月 31 日前获得证券交易所/中国证监会关于标的公司 IPO 的受理函或者被并购。

若乙方按约定实现上述第 2 条的合格股权融资事件的，则甲方第 2、3 条的回购权自动终止（即豁免标的公司及丙方的回购义务）。

甲方如行使回购权的情况下，回购价款为甲方投资总额加计年化 LPR+1.5%（单利）后的金额（计算期限自甲方支付完毕全部投资款之日起至丙方实际支付完毕全部股权回购价款之日）。如果在进行上述股权回购前，标的公司已向甲方分红或丙方向甲方支付过补偿，则甲方收到的分红款和补偿款应在回购价款中扣除。

（七）承诺条款

乙方、丙方无条件且不可撤销的向甲方作出下列声明、承诺及保证：

除甲方外，乙方本轮融资至少包含 1 个以上其他投资机构。

（八）最惠国优惠条款

若标的公司在既有的股东中存在比本次投资更加优惠的条款（“更优惠条款”），则甲方有权享受更优惠条款。

（九）约束力

本意向书旨在反映各方就对标的公司业务进行投资合作的主要条件所达成的共同意向。待签署最终协议后，以最终协议内容为准，本意向书失效。

违反有约束力条款的一方应赔偿其他当事方因其违约所受到的损失。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

华睿芯材成立于 2021 年，是一家国产光刻胶前沿科技成果转化企业，专注于半导体光刻胶及其相关配套化学品等关键微电子材料的研发、半导体光刻胶的产业化适配、光刻胶核心组分的量产。该公司主要从事基于“纳米金属氧化物的新型半导体光刻胶、电子束光刻胶及其成膜树脂”技术的光刻胶核心组分及相关配套化学品研发，致力于开发极紫外光刻胶、深紫外光刻胶、电子束光刻胶和高速 3D 打印光刻胶等系列产品。公司目前处于中试及产业化运营阶段，已建成光刻胶研发测试及中试平台，并配备相应的检测检验设备，已构建系列核心知识产权池。

思泰克作为专注于机器视觉检测设备的企业，核心产品主要用于各类 PCB 的 SMT 生产线中的品质检测环节与半导体后道封装中的制程环节，而光刻胶作为半导体和 PCB 制造的核心材料，其性能直接影响后续公司检测设备的应用效果和客户产品的最终良率。通过本次投资，公司不仅能向上游关键材料领域延伸，强化对客户工艺链条的全覆盖能力，提升整体解决方案的附加值，更能实现技术协同。

近年来，全球半导体市场规模持续扩大，对高端光刻胶的需求不断增加。目前，国外企业占据半导体光刻胶主要市场份额。随着国内半导体行业的快速发展，国内高端光刻胶的研发及生产日益加速，市场前景良好。早期布局拥有国产光刻胶关键技术的标的公司，是未来公司能够快速切入该等市场的重要举措。

因此，本次投资不仅是基于财务回报考量，更是通过与标的公司形成产业链协同效应，进一步提升公司核心产品及服务的市场竞争力，巩固公司行业领先地位。

（二）存在的风险

1、本次拟签署的《投资意向书》仅为意向性协议，在后续实施过程中尚存在不确定性因素，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署；标的公司及其实际控制人承诺，本轮融资至少包含 1 个以上除思泰克外的其他投资机构，截至本公告披露日，标的公司尚未确定其他投资方；本次对外投资事项的实施进度以及最终交易能否完成尚存在不确定性，可能存在对标的公司的进一步投资方案进行调整或取消的风险。

2、标的公司目前尚处于中试及产业化运营阶段，而光刻胶产品的客户验证周期长，客户黏性大，市场拓展难度相对较高，实现销售收入的时间尚存在不确定性；且光刻胶研发周期长、资金投入大，如标的公司产品进展未能取得良好效果、适配市场需求，则可能对经营及财务状况产生不利影响。

同时受宏观环境、行业政策、市场和技术变化、自身经营管理等多种因素的影响，标的公司未来经营情况及盈利能力存在一定的不确定性，公司存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资是基于公司战略布局，符合公司的长期发展战略规划，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资的资金来源为公司自有资金，若后续交易完成，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

截至本公告披露日，本次对外投资事项暂未签署正式协议，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、拟签署的《投资意向书》。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十六日